

	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日		△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△							△				
△							△				
適用規格											
定格	使用温度範囲	-35℃～+85℃(注1)				保存温度範囲	-10℃～+60℃(注3)				
	使用湿度範囲	40%～80%(注2)				保存湿度範囲	40%～70%(注3)				
	電圧	AC 250V				適合コネクタ	DF1B-*DS-2.5RC				
	電流	3A									
性能											
	項目	試験方法				規格				QT	AT
構造	外観、構造及び仕 上げ	目視、寸法測定器にて測定する。				図面と合致していること。				○	○
	表示	目視にて確認する。								○	○
電気的 性能	接触抵抗	100mA(DC又は1000Hz)で測定する。				30mΩ以下				○	—
	絶縁抵抗	DC 500Vで測定する。				1000MΩ以上				○	—
機械的 性能	耐電圧	AC 650Vの電圧を1分間印加する。				せん絡・絶縁破壊がないこと。				○	—
	繰り返し動作	50回の抜き差しを行う。				① 接触抵抗: 30mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。				○	—
	耐振性	周波数 10～55Hz、片振幅0.75mm、 で3方向各2時間試験する。				① 1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。				○	—
環境的 性能	耐衝撃性	加速度 490m/s ² 、持続時間 11ms、 正弦半波 3方向各3回試験する。				① 1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。				○	—
	定常状態の耐湿性	温度 40±2℃、湿度 90～95%中に 96時間放置する。				① 接触抵抗: 30mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 1000MΩ以上 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。				○	—
	温度サイクル	温度 -55→5→35→8.5→5→35℃ 時間 30→10→15→30→10→15分 を5サイクル試験する。				① 接触抵抗: 30mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 1000MΩ以上 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。				○	—
	はんだ耐熱性	【自動半田(70-)の場合】 半田温度 250℃、半田時間 10秒以内。 【手半田の場合】 半田ごと 300℃、3秒以内。 但し、端子に力を加えないこと。				外観の変形及び端子などの著しい ガタがないこと。				○	—
	はんだ付け性	はんだ温度 235±5℃、浸せき時間 5秒間のはんだ付けを行う。				半田浸せき面の95%以上が新しいはんだ でぬれていること。				○	—
備考						製図	設計	検図	承認	出国	
(注1) 通電による温度上昇を含む。											
(注2) 結露のないこと。											
(注3) 基板搭載前の未使用品に対する長期保存状態に適用。 基板搭載後、輸送時の一時保管は使用温湿度範囲を適用。											
試験規格の記載のない試験方法は JIS C 5402 を適用している。											
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目											
ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.						製品規格表			製品名 DF1B-*DP-2.5DSA(01)		
旧CL CL		図番 SLC4-071800-07				製品コード CL541				1 1	